

# 2006年中国半导体产业研究报告

## 报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2006年中国半导体产业研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析

。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/2805928059.html>

报告价格：电子版: 7000元 纸介版：7500元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

报告摘要2006年年底，中国国内有近50家晶圆制造厂，112家IC封测和IC装配厂，450家IC设计公司。2006年中国国内半导体业产值为807亿元人民币，大约为100亿美元，其中封测350亿元，晶圆制造242亿元，IC设计215亿元。中国国内半导体市场的规模在2006年超过600亿美元。其中前20大厂家就有占有300亿美元以上。表1 2006年中国内地半导体市场前20大供应商排名

排名	供应商名称
1	Intel
11	NEC
2	Samsung Electronics
12	Micron Technology
3	Texas Instruments
13	Infineon Technologies
4	AMD
14	Qimonda
5	Hynix
15	Sony
6	STMicroelectronics
16	Broadcom
7	NXP
17	ADI
8	Toshiba
18	Spansion
9	Freescale Semiconductor
19	Sharp Electronics
10	Renesas Technology
20	Panasonic

封测产业是中国半导体产业的主要部分，中国内地的封测企业都是为国外公司服务的。内地半导体市场前20大供应商大部分都在内地建立了的封测基地，要么是独资建立，要么是和海外的封测伙伴联合建立。国内最大的封测厂家其客户也主要是国外客户。

中国内地正式投产的晶圆厂有9家，这9家的简介表如下：表2中国内地正式投产的晶圆厂列表

企业名称	晶圆英寸	工厂编号	投产年份	工艺(微米)	规划月产能(万片)																								
中芯国际	8-1200	10.134.58-2200	2010	134.58-3200	30.131.5																								
12-4200	40.112.08-7200	10.253.65	宏力半导体	8-11	1994	12.56-2199	70.51.58-3200	30.254.5	华虹NEC	8-11	1999	0.253.58-2200	40.185.5	贝岭微电子	4-11	1997	0.81.6	华润上华	6-11	1998	0.3568-2200	50.353	台积电	8-10	2004	0.253.5	柏玛	8-12	040.353.0

这9家公司的年产能折合8英寸晶圆达到180万片，而国内IC设计公司对晶圆的年需求不到50万片。因此这些晶圆厂必须寻求海外订单。

这些小的生产线大部分处于停产或者半停产状态，或者一开始就是实验线。中国的晶圆厂分四大类型，第一大为海外华人投资，依托政府支持和资本操作来获得资金来源，技术人才大多来自台积电、联电和先进。以中芯国际为代表。其次是中外合资形式，华虹和NEC合资成立华虹NEC，先进半导体有飞利浦的投资。投资大多来自当地银行贷款，一般都主要为合资的外资方服务。第三种是台湾厂家改头换面或直接来投资，如和舰科技就是联电。南亚、茂德、力晶都打算2007年来中国内地投资，不过都是8英寸生产线。第四种是国内投资，这些国内投资资金主要来自银行贷款，很多是非理性上马的项目。产能利用率非常低，或者因为技术缺乏，长期无法投产。中国晶圆市场已经饱和，增长率在2005年以后大幅度放缓，但是受到优惠政策的刺激，晶圆厂依然大量涌现，在建的晶圆厂多达19个，其中蕴涵着巨量泡沫。2006年6月28日，中芯国际宣布由其经营的华中地区第一条12英寸集成电路生产线项目在湖北省武汉市的东湖国家高新技术区正式开工建设。该项目由湖北省、武汉市和东湖高新技术区联合投资建设，产权归武汉新芯集成电路制造有限公司，委托中芯国际集成电路制造有限公司经营管理。产业园的形式是以后中国半导体产业模式的走向。项目计划于2007年底建成并于2008年上半年投产。项目完成后当年预计将实现产能1.25万片/月，到2009

年产能将达到2.0万片 / 月至2.5万片/月。此举表明湖北省政府准备将武汉打造为半导体产业基地，陆续将会有更多进驻。日月光于2006年11月14日正式对外公布，美商凯雷投资公司已经向日月光董事会提出现金收购日月光100%股权的计划，并购价格为每股39元新台币，而日月光董事会已经同意这项收购案。估算并购总金额将高达1791亿元新台币，创下台湾收购案最大金额。而在取得多数股权后，日月光在台挂牌股票及在美ADR均将下市。据了解，凯雷将循渣打银行并购新竹国际商银模式，透过公开市场收购方式，买下日月光100%股权。在凯雷收购台湾日月光集团后，整个台湾的封测行业在大陆的投资进程会加快。

正文目录	第一章 中国半导体市场	第二章 晶圆制造产业简介	2.1 晶圆制造工艺简介	2.2 全球晶圆产业及主要厂商简介	2.3 中国半导体产业政策环境	2.4 中国晶圆制造业现状及预测
第三章 封测产业简介	3.1 封测工艺简介及未来发展趋势	3.2 全球IC封测市场简介	3.3 全球IC封测产业格局	3.4 中国IC封测产业发展历史及现状	3.5 中国IC封测产业格局	3.6 中国IC封测产业预测
3.7 中国二手半导体设备市场现状	3.8 二手IC设备制造商格局	3.9 二手IC设备进口相关政策	第四章 半导体设备厂商	4.1 Applied Materials	4.2 Tokyo Electron Limited	4.3 ASML
4.4 KLA-Tencor	4.5 尼康精机公司	4.6 Dainippon Screen	4.7 Novellus	4.8 Lam Research	第五章 晶圆厂商	5.1 中芯国际
5.2 上海华虹NEC电子有限公司	5.3 上海宏力半导体制造有限公司	5.4 华润微电子	5.5 上海先进半导体	5.6 和舰科技(苏州)有限公司	5.7 BCD半导体制造有限公司	5.8 方正微电子有限公司
5.9 中宁微电子公司	5.10 南通绿山集成电路有限公司	5.11 纳科(常州)微电子有限公司	5.12 珠海南科集成电子有限公司	5.13 康福超能半导体(北京)有限公司	5.14 科希-硅技半导体技术第一有限公司	5.15 光电子(大连)有限公司
5.16 西安西岳电子技术有限公司	5.17 吉林华微电子股份有限公司	5.18 丹东安顺微电子有限公司	5.19 敦南科技	5.20 福建福顺微电子	5.21 杭州立昂	5.22 杭州士兰微电子
5.23 宁波中纬	5.24 绍兴华越微电子	5.25 深爱半导体(sisemi)	5.26 赛米微尔(Semeware)	5.27 茂德科技	5.28 南京高新	5.29 上海汉升科集成电路
第六章 封测厂商	6.1 日月光	6.2 矽品	6.3 菱生精密	6.4 京元电	6.5 超丰电子	6.6 宁波明昕电子
6.7 宏盛科技	6.8 威宇科技GAPT	6.9 巨丰电子	6.10 通用半导体	6.11 瀚霖电子	6.12 捷敏电子	6.13 凯虹电子
6.14 桐芯科技	6.15南茂	6.16 Intel	6.17 摩托罗拉(Motorola)	6.18 飞利浦(Philips)	6.19 国家半导体(National Semiconductor)	6.20 超微(AMD)
6.21 安可科技(Amkor Technology)	6.22 新科金朋(STATS ChipPAC)	6.23 三星电子(SAMSUNG)	6.24 KEC	6.25新加坡联合科技(UTAC)	6.26 三洋半导体(蛇口)有限公司	6.27 东莞长安乐依文半导体装配测试厂(ASAT)
6.28 清溪三清半导体	6.29 上海新康电子	6.30 上海松下半导体	6.31 上海纪元微科微电子	6.32 瑞萨半导体(苏州)有限公司(原日立半导体(苏州)有限公司)	6.33 英飞凌科技(苏州)有限公司	6.34 矽格微电子(无锡)有限公司
6.35 南通富士通微电子	6.36 瑞萨四通集成电路(北京)有限公司	6.37 深圳赛意法电子	6.38			

天水华天科技股份有限公司（原甘肃永红） 6.39 浙江华越芯装电子股份有限公司 6.40  
骊山微电子 6.41 汕头华汕电子器件有限公司 6.42 华联电子有限公司 6.43 上海华旭微电子  
6.44 无锡华润安盛科技有限公司 6.45 中电华威电子（原连云港华威电子） 6.46  
江苏长电科技股份有限公司 6.47 邗江九星电子有限公司 6.48 玉祁红光电子 6.49  
桂林斯壮微电子有限责任公司（南方电子有限公司） 6.49 清溪矽德电子厂 6.50  
珠海南科电子有限公司部分图表目录部分图目录图 中国半导体市场各类型IC所占比例统计  
图 原始晶圆的加工流程图 图 晶圆植入电路的流程图 图 台积电的全球主要客户 图  
联电主要客户 图 新加坡特许半导体主要客户 图 中芯国际主要客户 图 封测技术发展路线图  
图 全球IC封测市场统计与预测 图 全球封测市场外包比例统计 图  
全球各类型封测出货量统计及预测 图 FC与线邦定成本对比未来预测 图  
全球前4大封测厂家毛利润、净利润对比 图 我国内地封装测试芯片数量及预测 图  
2003-2007我国内地封装技术及预测 图 Applied  
Materials公司2005年1季度-2006年4季度收入统计及预测 图 Applied  
Materials公司2005年1季度-2006年4季度净收入统计及预测 图 Applied  
Materials公司收入地域分布 图 Tokyo Electron Limited2006财年收入比例一览 图 Tokyo  
Electron Limited公司2001-2006年销售额统计 图 Tokyo Electron  
Limited公司2001-2006年利润统计 图 Tokyo Electron  
Limited公司2006财年各地域所占收入比例统计 图 ASML历年市场占有率统计 图  
ASML公司2001-2006年收入统计 图 ASML公司产品结构图 ASML公司按技术分产品结构图  
ASML公司客户分布 图  
ASML公司2005年1季度-2006年3季度订单额与出货量及出货类型统计 图 KLA-  
Tencor公司1999-2006年收入 图 尼康精机1981-2006年半导体设备出货量（台） 图  
尼康精机1997-2006年按地域收入统计 图 尼康精机1997-2006年收入按产品技术类型统计  
图 2006财政年度Dainippon Screen公司的收入比例结构 图 2006财政年度Dainippon  
Screen公司的收入地区结构 图 Dainippon  
Screen公司2003-2006年半导体设备部门的收入统计与预测 图  
Novellus公司2001-2006年销售额统计 图 Novellus公司2001-2006年利润统计 图  
Novellus公司2001-2006年平均每个员工的销售额统计 图  
Advantest公司2003年-2006年半导体设备部门销售额统计 图  
Advantest公司2003年-2006年地区销售比例统计 图 中芯国际2006年Q3各厂产能 图  
中芯国际2005年Q1 - 2006年Q3各区域销售比例 图  
2002 - 2006年前四大foundry市占率对比 图 台积电、联电和中芯国际产能分析 图  
台积电、联电和中芯国际制程分析 图 中芯国际晶圆厂年使用率 图  
中芯国际2004年Q1 - 2006年Q3营收与毛利率 图 上海华虹NEC技术升级计划 图  
宏力半导体逻辑类技术的发展规划 图 宏力半导体闪存类技术的发展规划 图 BCD产品分类

图 BCD系列产品	图 BCD系列产品	图 BCD系列产品	图 BCD系列产品	图
2002-2006年华微电子营业收入与毛利率统计	图	中纬工艺路线	图	
2000-2006财年日月光集团业绩(含子公司)	图	2000-2006财年日月光半导体制造公司业绩	图	
图 2006财年日月光半导体销售收入地域分布	图	日月光半导体市场占有率变化图	图	
2005Q1-2006Q3日月光集团(含子公司)业绩	图			
2005Q1-2006Q3日月光集团(含子公司)IC封装部门业绩	图			
2005Q1-2006Q3日月光集团(含子公司)IC封装收入组成	图			
2005Q1-2006Q3日月光集团(含子公司)测试部门业绩	图			
2005Q1-2006Q3日月光集团(含子公司)测试部门组成	图	矽品科技封装技术演化图	图	
2001-2006矽品科技销售业绩	图	2002-2006财年矽品科技销售收入组成	图	
2002-2006财年矽品科技销售收入地域分布	图	2001-2006年矽品科技市场占有率变化图	图	
2001-2006财年菱生精密销售业绩	图	2006财年菱生精密销售收入地域分布	图	
2005Q1-2006Q3菱生精密销售业绩	图	2005Q1-2006Q3京元电销售业绩	图	
2001-2006财年京元电销售业绩	图	2001-2006财年超丰电子销售业绩	图	
2001-2006财年上海宏盛科技业绩	图	2006财年上海宏盛科技销售收入主要产品来源	图	
2001-2006财年南茂科技业绩	图	2002-2006财年南茂科技销售收入组成	图	
2006财年南茂销售收入地域分布	图	2006年前10大封装测试公司	图	
安可科技2001-2006年按季度营收	图	Amkor在全球的市场占有率	图	
新科金朋合并前后封装的产品领域分析	图	新科金朋合并前后封装测试所占比例情况	图	
新科金朋2005年1季度-2006年3季度财务情况	图	联合科技2005-2006年3季度分季营收状况	图	
图 联合科技2006年产品分类营收	图	联合科技2006年封装及测试所占营收比例	图	
联合科技2006年产品按应用领域的营收	图	联合科技2006年产品按地区营收状况	图	
2002-2006年江苏长电公司主营业务收入及净利润率变化情况	图	IC产量情况 产量(百万只)	图	
图 DISCRETE	DEVICE	产量情况	产量(百万只)	图
江苏长电股份有限公司人员构成部分表目录表	中国主要消费类电子产品产量统计	表		
2006年大陆半导体市场前20大供应商	表	半导体各领域主要厂商	表	
2005年全球前20大纯晶圆代工厂收入及增幅统计	表			
中国已经投产的主要6、8、12英寸晶圆厂简介一览	表			
中国在建的6、8、12英寸晶圆厂简介一览	表	中国4、5、6英寸晶圆厂名单	表	
中国前6大晶圆厂2006年收入一览	表	2006年全球10大封测厂家	表	
2006年半导体设备10大供应商排名	表	中芯国际主要晶圆代工厂情况	表	
中芯国际技术文件的支持	表	中芯国际现有的单元库	表	
0.35 μm 5V 工艺(CZ6H)概况一览	表			
0.35 μm 5V的嵌入式EEPROM 工艺(CZ6HFT)概况一览	表	0.35 μm 3.3V 工艺(UC1)概况一览	表	
表 宏力主要产品的设计规则	表	宏力0.25微米工艺技术主要特性	表	
0.25微米器件的电性设计参数	表	宏力0.15微米技术的主要工艺参数	表	

0.15微米器件的电性设计参数 (EDR) 表 宏力的电子商务体系功能 表  
华润微电子产品类型 表 BCD产能一览 表 中纬服务流程 表  
2006年日月光主营业务销售收入商品种类列表 表 矽品科技测试技术 表 菱生精密封装类型  
表 菱生精密的测试服务 表 超丰电子封装能力 表 超丰电子测试能力 表  
台湾华昕目前的封装能力 表 2006财年宁波明昕微电子股份有限公司业绩 表  
吴江巨丰电子测试能力列表 表 英特尔产品(上海)有限公司概况一览 表  
摩托罗拉(天津)测封厂概况一览 表 飞利浦半导体(广东)有限公司概况一览 表  
飞利浦半导体(苏州)有限公司概况一览 表 国家半导体(苏州)有限公司中国大陆客户 表  
国家半导体(苏州)有限公司概况一览 表 AMD在华企业概况一览 表 安可全球客户一览 表  
Amkor在全球封测行业的排名 表 安可封装测试(上海)有限公司概况一览 表  
新科金朋全球分领域客户表 表 新科金朋与全球主要晶圆代工企业的合作关系 表  
新科金朋(上海)有限公司概况一览 表 三星电子(苏州)半导体有限公司概况一览 表  
无锡开益禧半导体有限公司 表 中山开益禧半导体有限公司概况一览 表  
新加坡联合科技主要客户 表 ASAT公司主要客户 表 ASAT主要封装形式 表  
上海松下半导体主要封装形式 表 上海纪元微科微电子主要封装形式 表  
瑞萨半导体(苏州)有限公司主要封装形式 表 矽格电子的主要封装形式 表  
南通富士通主要封装形式 表 南通富士通封装系列产品 表 瑞萨四通主要封装形式 表  
天水华天主要封装形式 表 安盛科技主要封装形式

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/2805928059.html>